

Product Change Notice (PCN)

件名: RH850 シリーズ Wafer Test の拠点追加

発行日: 5/28/2026

出荷開始予定日: 3/1/2027

改版履歴: 初版

変更内容の説明:

RH850 シリーズの Wafer Test 拠点を追加致します。

| 項目 | 変更前 拠点 | 変更後 拠点 |
|------------|-----------|-----------------|
| Wafer Test | TeraPower | 那珂工場, TeraPower |

※車載 MCU 需要拡大に伴い、Wafer Test 拠点到那珂工場を追加致します。

対象製品リスト: 付録欄“製品リスト”をご参照ください。

変更の理由: 安定供給のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

本変更による外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法: 製品の T/C (トレースコード) から、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて: 対象外

サンプル出荷予定日: 対象外

製品/材料の化学物質データ: 対象外

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

付録
製品リスト

PCN#[HBLM-2026-0441]
PC-MCU-A047A/J

RH850/P1H-C シリーズ

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| R7F701371EABG-C#AC1 | R7F701371EABG-C#BC1 | R7F701371EABG-C#HC1 | R7F701326EABG#KC1 |
| R7F701396AEABG-C#AC1 | R7F701396AEABG-C#BC1 | R7F701396AEABG-C#HC1 | R7F701372AEABG-C#AC1 |
| R7F701372AEABG-C#BC1 | R7F701372AEABG-C#HC1 | R7F701393AEABG#KC1 | R7F701327AEABG#KC1 |

RH850/E1M-S2 シリーズ

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| R7F701215EABA-C#BC0 | R7F701215EABG-C#BC0 | R7F701216EABA-C#BC0 | R7F701216EABG-C#BC0 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

RH850/E2M シリーズ

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| R7F702002AEABA-C#AC0 | R7F702002AEABA-C#BC0 | R7F702002AEABG-C#AC0 | R7F702002AEABG-C#BC0 |
| R7F702003AEABA-C#BC0 | R7F702005AEABG-C#BC0 | | |